惠州市容盛微科技有限公司

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

系列规格书 · Series Specification

客户名称 / CUSTOMER：_____

项目 Item	内容 Content
产品名称 PART NAME	多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor
产品系列 SERIES	0201 封装（公制 0603）· COG 温度特性（I 类）
覆盖型号 COVERED MODELS	70 个型号（0.3pF ~ 330pF · 50V ~ 50V，详见第 0 章）
具体型号 / 文件编号 SPECIFICATION NO.	RCC-JS-SER-0201COG-500 / V1.0-2026
发出日期 ISSUED DATE	2026-09-20

制造商 MANUFACTURER	客户 CUSTOMER
批准 / 审核 / 经办	批准 / 审核 / 经办
APPROVED / CHECKED / PREPARED	APPROVED / CHECKED / PREPARED

惠州市容盛微科技有限公司（制造商 / MANUFACTURER）

地　　址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖智能制造产业园厂房 2# 楼第 6 层 01 号

网　　址：www.mlccon.com

目　　录

（打开后如未显示页码，请右键选择「更新域」）

引用标准与引用规范 Normative References

编号 No.	名称 Title
GB/T 1.1—2020	标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则
IEC 60384-21	电子设备用固定电容器　第 21 部分：分规范　表面安装固定多层瓷介电容器（1 级）
IEC 60384-22	电子设备用固定电容器　第 22 部分：分规范　表面安装固定多层瓷介电容器（2 级）
EIA RS-198	陶瓷介质固定电容器（I 类 / II 类）

文件 Document	编号 / 版本 No. / Version	作用 Role
《容盛微文档生成规范》	V1.1（20260922）	上位规范：引用标准与规范须在文件前三页标明；数据冲突须标明冲突项并人工纠正
《容盛微 MLCC 产品规格书生成规范》	RCC-GF-001 / V1.1	本领域规范：文档结构、取数、合规与放行要求的执行基线
《惠州市容盛微科技有限公司　多层片式瓷介电容器　承认书》	RSC-JS-001 / V1.0	物理参数（介质特性 / DF / IR / 耐电压 / 尺寸 / 包装）的唯一权威来源

※ 引用版本取自生成时的现行有效受控件；受控件升级后须重新生成本文档。

0. 本规格书覆盖范围 Coverage of This Specification

本章说明本规格书适用于哪些型号。凡落入本章所述范围的型号，均以本规格书为准，无需另行索取单型号规格书；超出本章范围时请索取对应系列的规格书。

0.1 适用声明 Coverage Statement

本规格书适用于惠州市容盛微科技有限公司 0201（公制 0603）封装、COG 温度特性介质、额定电压 50V 的全部多层片式瓷介电容器，共 70 个可供型号。

凡料号符合下列通配形式者，均属本规格书覆盖范围：

RCC 0201 COG 【容量码】【容差码】 500 【厚度码】 T 【特殊标识】

即：系列代码 RCC、尺寸码 0201、介质码 COG、额定电压码 500（50V）、包装码 T 为固定段；容量码、容差码、厚度码、特殊标识按本规格书第 0.2 ~ 0.5 节取值。字段含义与编码规则见第 3 章。

※ 同一型号的多段组合不在此列时（例如其他封装、其他介质、其他额定电压），请索取对应系列规格书。

0.2 覆盖维度汇总 Coverage Summary

覆盖维度 Dimension	本规格书覆盖范围 Coverage	档位数	备注 Remark
① 封装尺寸 Chip Size	0201（公制 0603）· 0.60 × 0.30 mm	1	见第 5 章
② 温度特性 Dielectrics	COG（I 类 · 0 ± 30 ppm/℃ · -55℃ ~ +125℃）	1	见第 3.1 节
③ 额定电压 Rated Voltage	50V ~ 50V	1	见第 0.4 节
④ 标称容量 Capacitance	0.3pF ~ 330pF	43	见第 4 章
⑤ 容量容差 Tolerance	±0.05pF（?，2 个）/ ±0.1pF（?，15 个）/ ±0.25pF（?，20 个）/ ±1%（?，7 个）/ ±10%（K，1 个）/ ±2%（?，6 个）/ ±5%（J，19 个）	7	见第 6.3 节
⑥ 厚度 Thickness	0.3 mm（Z 码，70 个）	1	见第 5 章
⑦ 包装 Packing	T（Tape & Reel 编带包装（7″盘））	1	见第 8 章
⑧ 特殊标识 Special Suffix	(无) 70 个	1	见第 0.5 节

※「档位数」为该维度在本系列中实际出现的不同取值个数；各维度的组合并非全排列，实际可供型号共 70 个。

0.3 容量 × 额定电压 覆盖矩阵 Coverage Matrix

下表为 0201 COG（额定电压 50V）系列的完整可供矩阵：行 = 标称容量，列 = 额定电压；单元格内字母为该组合可供的容量容差码（K = ±10%，M = ±20%，J = ±5%），单元格为空表示该「容量 + 电压」组合不供货。

容量	50V
0.3pF	C
0.5pF	ABC
0.6pF	B
0.75pF	BC
1pF	BC
1.2pF	BC
1.3pF	BC
1.5pF	BC
1.8pF	B
2pF	ABC
2.2pF	BC
2.7pF	BC
3pF	BC
3.3pF	BC
3.9pF	C
4.7pF	BC
5pF	C
5.6pF	C
6pF	C
6.8pF	B
8pF	C
8.2pF	C
9pF	C

10pF	FGJ
12pF	FJ
15pF	FGJ
18pF	GJ
20pF	J
22pF	FG
24pF	J
27pF	J
33pF	FGJK
39pF	J
47pF	FJ
51pF	J
62pF	J
100pF	FGJ
120pF	J
150pF	J
180pF	J
200pF	J
220pF	J
330pF	J

※ 矩阵共 43 行 × 1 列，非空单元格 43 个。单元格内的字母表示该「容量 + 电压」组合可供的容差档，70 个标准型号（无特殊标识）分布其上；另有 0 个带尾部特殊标识的型号与同组合标准型共用单元格（见第 0.6 节），全系列在册型号合计 70 个。

0.4 按额定电压的规格反查表 Reverse Lookup by Rated Voltage

按额定电压档反查该档的可供容量范围、容差、厚度码与最小包装量：

额定电压	料号数	容量档数	容量范围	容差	厚度（代码）	最小包装 pcs
50V	70	43	0.3pF ~ 330pF	±0.05pF / ±0.1pF / ±0.25pF / ±1% / ±10% / ±2% / ±5%	Z（0.3 mm）	15,000

※ 最小包装量即编带每盘颗数（T 包装），按承认书 RSC-JS-001 第 7.2 节编带式包装表取值（数据源唯一，不采用在售平台标注的包装数）。

※ 同一电压档内不同厚度的最小包装量不同，以本表为准；实际出货以包装标签为准。

0.5 完整型号清单 Complete Model List

下列清单逐项列出本规格书覆盖的全部 70 个型号，按额定电压升序、容量升序、容差与厚度顺序排列。客户可直接以本清单核对选型。

0.5.1 50V 档（70 个型号）

型号 Model	型号 Model	型号 Model
RCC0201COG0R3C500ZT	RCC0201COG3R0C500ZT	RCC0201COG220F500ZT
RCC0201COG0R5A500ZT	RCC0201COG3R3B500ZT	RCC0201COG220G500ZT
RCC0201COG0R5B500ZT	RCC0201COG3R3C500ZT	RCC0201COG240J500ZT
RCC0201COG0R5C500ZT	RCC0201COG3R9C500ZT	RCC0201COG270J500ZT
RCC0201COG0R6B500ZT	RCC0201COG4R7B500ZT	RCC0201COG330F500ZT
RCC0201COGR75B500ZT	RCC0201COG4R7C500ZT	RCC0201COG330K500ZT
RCC0201COGR75C500ZT	RCC0201COG5R0C500ZT	RCC0201COG330G500ZT
RCC0201COG1R0B500ZT	RCC0201COG5R6C500ZT	RCC0201COG330J500ZT
RCC0201COG1R0C500ZT	RCC0201COG6R0C500ZT	RCC0201COG390J500ZT
RCC0201COG1R2B500ZT	RCC0201COG6R8B500ZT	RCC0201COG470F500ZT
RCC0201COG1R2C500ZT	RCC0201COG8R0C500ZT	RCC0201COG470J500ZT
RCC0201COG1R3B500ZT	RCC0201COG8R2C500ZT	RCC0201COG510J500ZT
RCC0201COG1R3C500ZT	RCC0201COG9R0C500ZT	RCC0201COG620J500ZT
RCC0201COG1R5B500ZT	RCC0201COG100F500ZT	RCC0201COG101F500ZT
RCC0201COG1R5C500ZT	RCC0201COG100G500ZT	RCC0201COG101G500ZT
RCC0201COG1R8B500ZT	RCC0201COG100J500ZT	RCC0201COG101J500ZT
RCC0201COG2R0A500ZT	RCC0201COG120F500ZT	RCC0201COG121J500ZT
RCC0201COG2R0B500ZT	RCC0201COG120J500ZT	RCC0201COG151J500ZT
RCC0201COG2R0C500ZT	RCC0201COG150F500ZT	RCC0201COG181J500ZT
RCC0201COG2R2B500ZT	RCC0201COG150G500ZT	RCC0201COG201J500ZT
RCC0201COG2R2C500ZT	RCC0201COG150J500ZT	RCC0201COG221J500ZT
RCC0201COG2R7B500ZT	RCC0201COG180G500ZT	RCC0201COG331J500ZT
RCC0201COG2R7C500ZT	RCC0201COG180J500ZT	
RCC0201COG3R0B500ZT	RCC0201COG200J500ZT	

0.6 特殊标识说明 Notes on Special Suffix

本系列含 0 个带尾部特殊标识的型号。该标识位的确切工程含义由制造商另行书面确认；在确认前，其电气规格按同参数标准型（无标识）处理。

标识位	型号数	其中与标准型同规格	仅标识款独有	说明
(无)	70	70	0	—

1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material

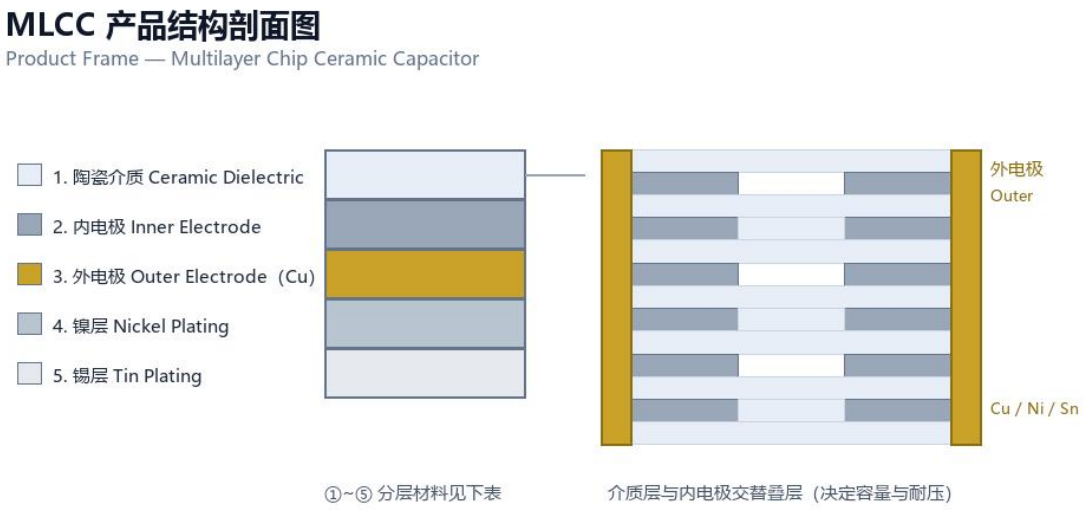
※ COG：此类介质材料的电容器为 I 类电容器，电性能稳定，几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗、稳定性要求高的电路中，如滤波器、谐振器和计时电路。国际通用写法亦作 C0G / NP0，容盛微料号中统一写作 COG。

※ M3L：此类介质材料的电容器为 I 类低失真型电容器，电性能稳定，几乎不随电压和时间的变化而变化，容量随温度变化率为 -0.1%/℃（变化范围 -0.05%/℃ ~ -0.20%/℃），适用于低损耗、要求较高的电路中。

※ X7R / X7T / X7S / X6S / X5R / Y5V：此类介质材料的电容器为 II 类电容器，具有较高的介电常数，容量比 I 类电容器高，具有较稳定的温度特性，适用于容量范围广、稳定性要求中等的电路中，如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路。

※ 本规格书覆盖I 类电容器，介质为 COG，全系列工作温度范围 -55℃ ~ +125℃，容量范围 0.3pF ~ 330pF，额定电压 50V ~ 50V。

2. 产品结构 Product Frame



序号 No.	名称 Name	材料 Material
1	陶瓷介质 Ceramic dielectric	COG 陶瓷介质（I 类）
2	内电极 Inner electrode	镍（Ni）内电极
3	外电极 Outer electrode	铜（Cu）
4	镍层 Nickel plating	电解镀镍 1~3 μm
5	锡层 Tin plating	雾锡镀层 3~6 μm

※ 介质层与内电极交替叠层，叠层数与介质厚度共同决定产品的容量与额定电压。

3. 产品规格型号命名规则 Product Parts Numbering System

容盛微 MLCC 料号由 8 段（含可选的尾部特殊标识为 9 段）组成，结构为「系列代码 + 尺寸 + 介质 + 容量 + 容差 + 电压 + 厚度 + 包装 + 特殊标识」。

RCC 0201 COG 8R2 ? 500 Z T

字段 Field	示例值	含义 Meaning
① 系列代码 Series	RCC	多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor
② 尺寸 Chip Size	0201	英制尺寸 0201 = 0.60 × 0.30 mm（公制 0603）
③ 温度特性 Dielectrics	COG	介质温度特性（COG：0 ± 30 ppm/℃，-55℃ ~ +125℃）
④ 容量 Capacitance	8R2	3 位容量码：前 2 位有效数字 + 第 3 位倍率（pF）。例：104 = 10×10⁴ pF = 100nF；含 R 时作小数点，例：1R2 = 1.2pF
⑤ 容差 Tolerance	?	本系列可取 ±5%（J）/ ±10%（K）/ ±20%（M），逐档可用性见第 0.3 节矩阵
⑥ 额定电压 Rated Voltage	500	2~3 位电压码（V）。例：500 = 50V；101 = 100V；102 = 1kV；202 = 2kV
⑦ 厚度 Thickness	Z	厚度码。本系列可取 Z（对应 0.3 mm）
⑧ 包装 Packing	T	T = Tape & Reel 编带包装（7″ 盘）
⑨ 特殊标识 Special Suffix	（可省略）	0~3 位可选标识，本系列出现 ；含义以制造商书面确认为准，见第 0.6 节

※ 示例型号 RCC0201COG8R2C500ZT 的含义：0201 封装、COG 介质、8.2pF、±0.25pF、额定 50V、厚度 0.3 mm、编带包装。

3.1 介质特性组别表 Dielectric Characteristics

材质 Material	工作温度范围 Operating Temp.	温度系数/特性 Temp. Char.	备注 Remark
COG (C0G/NP0)	-55℃ ~ +125℃	0 ± 30 ppm/℃	I 类 · 本规格书
M3L	-55℃ ~ +125℃	-0.05%/℃ ~ -0.20%/℃	I 类
X7R	-55℃ ~ +125℃	±15%	II 类
X7T	-55℃ ~ +125℃	+22% / -33%	II 类
X7S	-55℃ ~ +125℃	±22%	II 类
X6S	-55℃ ~ +105℃	±22%	II 类
X5R	-55℃ ~ +85℃	±15%	II 类
Y5V	-30℃ ~ +85℃	+22% / -82%	II 类

※ 上表为容盛微当前在产介质范围，共 8 种。

4. 产品容量范围 Capacitance Range

本规格书覆盖 0201（公制 0603）封装、COG 介质。下表按额定电压档列出可供容量范围：

序号	额定电压	容量范围	容量档数	可供容差
1	50V	0.3pF ~ 330pF	43	±0.05pF / ±0.1pF / ±0.25pF / ±1% / ±10% / ±2% / ±5%

※ 本系列整体容量范围 0.3pF ~ 330pF，共 43 个容量档、1 个电压档、43 个「容量 + 电压」组合。

※ 以上容量范围由容盛微现行可供规格统计所得，具体容量取决于使用要求，以最新版规格书为准。

※ 逐档可用性以第 0.3 节覆盖矩阵为准；某电压档的容量上限与该档耐压等级相关。

5. 产品尺寸 Dimensions

本规格书覆盖 0201（公制 0603）单一封装尺寸，外形尺寸如下：

规格 Type	L (mm)	W (mm)	e (mm)	g min (mm)	T (mm) / 代码
0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.10~0.20	0.20	0.3 mm（Z）

※ 本系列厚度共 1 档，与最小包装量的对应关系见第 0.4 节与第 8 章。

※ 尺寸依据《容盛微 多层片式瓷介电容器 承认书 RCC-JS-001》第 5 章尺寸表。

6. 技术要求和测试条件 Specification and Test Condition

下表列出本系列（COG · 0201 · 0.3pF ~ 330pF · 50V ~ 50V）的完整技术要求与测试条件。通用项全系列一致；与电压档或容量档相关的项目，另以分档子表列出。

编号	测试项目 Test Item	技术要求 Specification	测试条件 Testing Condition
6.1	外观 Appearance	无损伤、无异常现象	目视检查 Visual inspection
6.2	尺寸 Dimensions	在规格范围内（见第 5 章）	用千分尺 Calipers on micrometer
6.3	容量 Capacitance	在容差范围内；容差按型号取 ±5%(J) / ±10%(K) / ±20%(M)，各电压档的容量范围见第 4 章	1.0±0.2Vrms, 1 kHz±10%（Cp > 10μF 时为 120±24 Hz）, 25±3℃，湿度 ≤ 70%RH
6.4	损耗 Dissipation Factor	见 6.4 分档子表	1.0±0.2Vrms, 1 kHz±10%, 25℃
6.5	绝缘电阻 IR	见 6.5 分档子表	U 测 = 额定电压（≤ 400V）；充电 60±5 秒；25℃
6.6	耐电压 Dielectric Strength	无击穿、无飞弧	见 6.6 分档子表
6.7	温度特性 Temp. Coefficient	容量变化在 0 ± 30 ppm/℃ 以内	3 点法：-55℃ → 25℃ → +125℃
6.8	附着力 Adhesion	端电极无松动、无其他缺陷	施加 6 N（600 g·f）压力，10±1 秒
6.9	可焊性 Solderability	端电极挂锡面积 ≥ 95%	245±5℃，2±1 秒浸入
6.10	耐焊性 Resistance to Leaching	挂锡 ≥ 95%，外观无开裂	预热 120~150℃/60 秒 + 270±5℃/10±1 秒
6.11	端电极结合强度 Bending	无可见损伤；Cp 变化 ≤ ±5% 或 0.5pF（取较大值）	1.0 mm/s 速率弯曲至 1.0 mm
6.12	耐焊接热 Soldering Heat	无明显损伤；Cp 变化 ≤ ±2.5% 或 0.25pF（取较大值）	270±5℃，10±1 秒；室温放置 48±4h 后测量
6.13	温度快速循环 Temp. Cycle	无明显损伤；Cp 变化 ≤ ±2.5% 或 0.25pF（取较大值）	5 次循环：-55℃ 30min → 25℃ 2~3min → +125℃ 30min → 25℃ 2~3min
6.14	稳态湿热 Moisture Resistance	外观无损伤；Cp 变化 ≤ ±5% 或 0.5pF（取较大值）	40±2℃ / 90~95%%RH / 500±12h
6.15	耐湿负荷 Damp Heat with Load	外观无损伤；Cp 变化 ≤ ±7.5% 或 0.75pF（取较大值）	40±2℃ / 90~95%%RH / 500±12h，施加额定电压
6.16	耐久性 Life Test	外观无损伤；Cp 变化 ≤ ±3% 或 0.3pF（取较大值）	125±3℃ / 1.5 倍额定电压 / 1000h

6.4 损耗角正切分档 Dissipation Factor

适用电压条件	容量条件	损耗角正切限值
额定电压 ≤25V	Cp ≤ 220nF	DF ≤ 10.0%
额定电压 ≤25V *	Cp > 220nF	DF ≤ 10.0% *
额定电压 >25V *	不区分容量	DF ≤ 10.0% *

※ 标注「*」的 2 个档位，其「封装 × 电压段」组合未在承认书 §6.4 表中列出，现按表内趋势外推取值（取同一封装已列档位中的最宽松值，不严于承认书已认可的档）；最终限值以工厂书面确认为准。

6.5 绝缘电阻分档 Insulation Resistance

额定电压条件	绝缘电阻限值	本系列适用电压档
U ≤ 50V	≥ 10 GΩ 或 100 Ω·F（取较小值）	50V
U > 50V	≥ 4 GΩ 或 100 Ω·F（取较小值）	

6.6 耐电压分档 Dielectric Strength

适用电压档	施加倍率	施加电压（按档）	最大电流
U ≤ 50V	300%	50V（150V）	≤ 50 mA

※ 测试环境：温度 25℃±3℃，湿度 < 70%RH。

※ 损耗分档规则 —— I 类 COG 以品质因数 Q 表征损耗：Cp ≥ 30pF 时 Q ≥ 1000；Cp < 30pF 时 Q ≥ 400 + 20×Cp；测试频率 1 MHz（Cp > 1000pF 时 1 kHz）

※ COG 为 II 类介质，初始值测量需先经 150℃ 热处理 1 小时，再于室温放置 48h 后进行（去老化处理）。

※ 6.15 耐湿负荷、6.16 耐久性两项可靠性试验仅适用于常规产品，不适用于中高压产品。

7. 特性曲线 Characteristic Curves

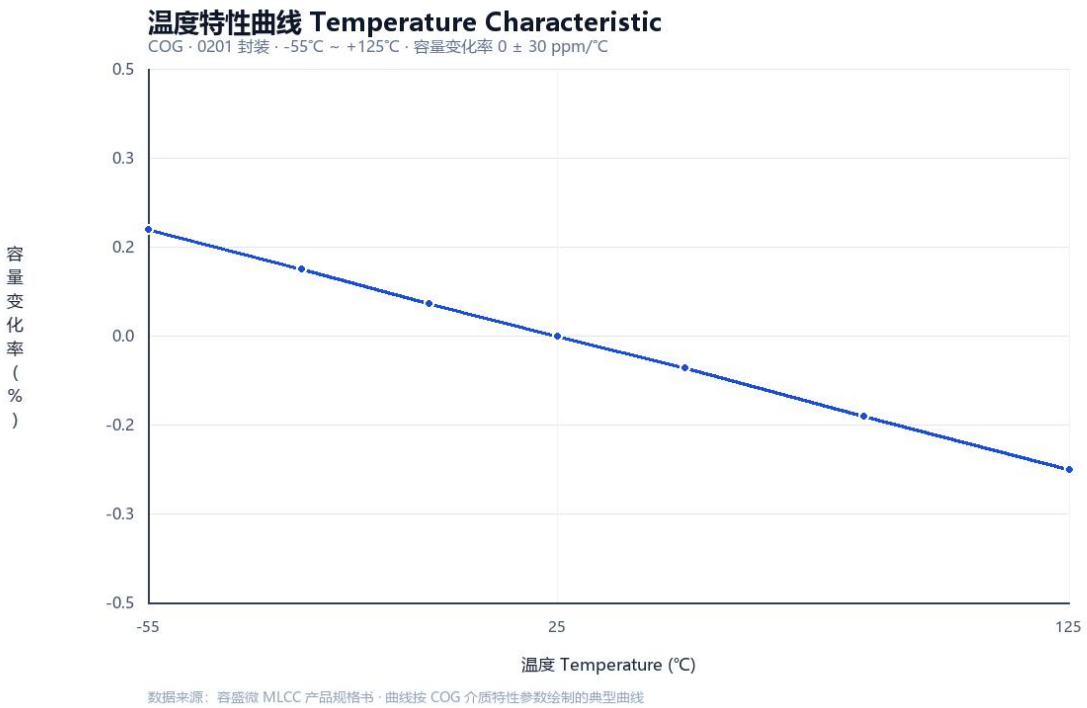
本规格书提供三类特性曲线，用于终端客户评估实际工作条件下的容量表现。曲线按 COG 介质的特性参数绘制，并按额定电压档分别给出直流偏压曲线；测试条件见各图标注。

顺序	曲线名称	横轴	纵轴	绘制口径	适用场景
①	温度特性 Temperature	温度 (℃)	ΔC/C (%)	全系列共用	评估介质可用温区与容量漂移
②	直流偏压 DC Bias	直流偏压 (V)	ΔC/C (%)	按额定电压档分别绘制	评估工作电压下的有效容量裕量
③	频率特性 Frequency	频率 (Hz)	ΔC/C (%)	全系列共用	评估滤波、旁路等高频场景

※ 顺序说明：本规格书按终端客户的实际选型决策链排列特性曲线为「① 温度特性 → ② 直流偏压 → ③ 频率特性」——先确认介质可用温区，再确认工作电压下的容量裕量，最后看频率响应。

7.1 温度特性曲线 Temperature Characteristic

温度特性仅由介质决定，全系列共用同一条曲线：



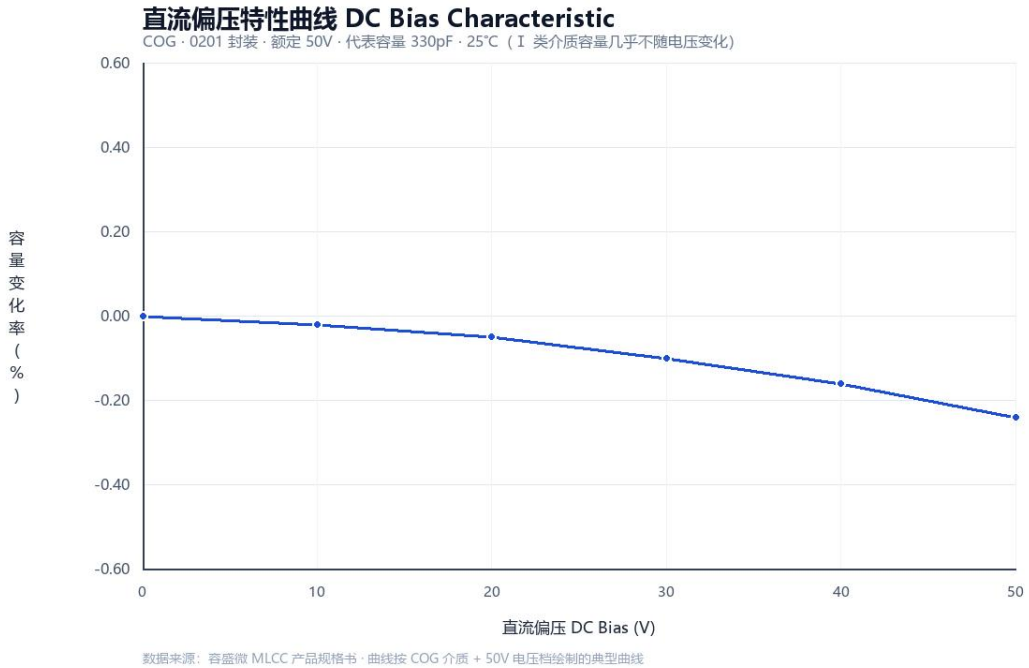
※ 测试方法：3 点法：-55℃ → 25℃ → +125℃。温度特性范围 0 ± 30 ppm/℃。

※ 曲线为按 COG 介质特性参数绘制的典型曲线，非逐型号实测点；如需特定型号的实测曲线请联系制造商。

7.2 直流偏压特性曲线 DC Bias Characteristic

直流偏压下的容量衰减与「容量 / 耐压」密度相关，故按额定电压档分别绘制；各图以该电压档中容量最大（衰减最保守）的型号为代表。共 1 档：

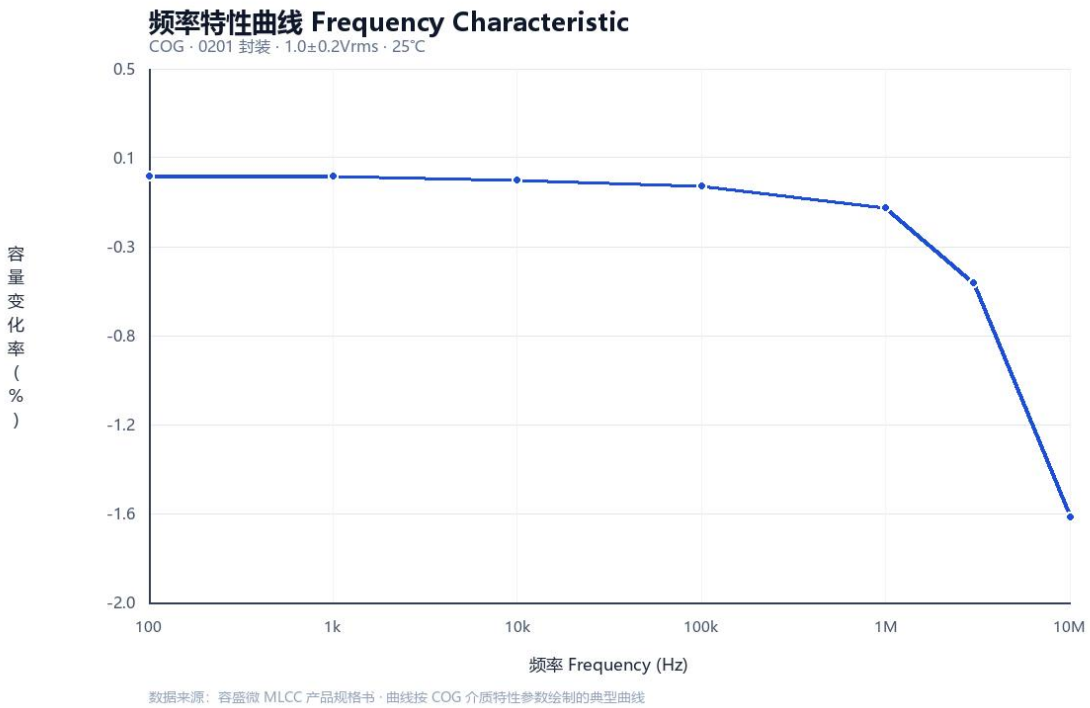
7.2.1 额定电压 50V 档



※ 测试条件：25℃，1.0±0.2Vrms。II 类介质的容量随施加直流电压升高而下降，设计时应按实际工作电压下的有效容量核算裕量。

7.3 频率特性曲线 Frequency Characteristic

频率特性由介质类别决定，全系列共用同一条曲线：



※ 测试条件：25℃，1.0±0.2Vrms。高频段本产品的容量衰减与等效串联电阻（ESR）上升明显，高频应用请以实测阻抗曲线为准。

8. 产品包装 Packing

8.1 包装方式 Packing Type

本系列标准包装为编带包装（Tape & Reel，7″ 盘），包装代码 T；袋式散装（Bulk，10,000 pcs/袋）可按客户要求提供。Standard packing: Tape & Reel (7″ reel), others according to customer request.

8.2 编带每盘数量 Reel Quantity（0201）

规格 Type	L (mm)	W (mm)	T (mm) / 代码	纸带 pcs/盘	塑料带 pcs/盘
0201	0.60	0.30	0.3 mm（Z）	15,000	—

※ 依据承认书 RSC-JS-001 第 7.2 节：0201 尺寸当厚度 ≤ 0.85 mm 时采用纸带（Paper Tape）；厚度 > 0.85 mm 时采用塑料带（Embossed Plastic Tape，压纹载带）。

※ 表中数量为该厚度档的额定每盘数量，取自承认书第 7.2 节编带式包装表；同一厚度档的不同型号数量一致。

8.3 载带尺寸 Tape Dimensions（0201）

规格 Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)
0201	0.36±0.03	0.67±0.03	2.0±0.10	2.0±0.05	0.42 max

※ 上表为纸带（Paper Tape）孔尺寸，适用于厚度 ≤ 0.85 mm 的型号。

※ 上胶带剥离力应为 0.1 ~ 0.6 N（Peeling off force: 0.1 to 0.6 N）。

※ 载带尺寸依据《容盛微 多层片式瓷介电容器 承认书》第 7.2 节，实测以包装图纸为准。

8.4 内盒 / 外箱 Inner Box & Outer Carton

内盒与外箱规格：承认书未载明；如需请由制造商按订单另行书面确认。

※ 按 RCC-GF-001 §6.10：承认书未载明的包装项不得书写行业通行值，故本节不予列示。

9. MLCC 使用注意事项 Precautions on the Use of MLCC

9.1 电路板设计 PCB Design —— 0201 推荐焊盘尺寸

规格	L	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0201 再流焊	0.60	0.30	0.20~0.25	0.20~0.30	0.25~0.35
0201 波峰焊	0.60	0.30	0.20~0.25	0.20~0.30	0.25~0.35

※ 推荐焊盘尺寸依据 IPC-7351B 标准，实际设计请结合容盛微工艺能力确认。

※ 过量的焊锡会影响产品抵抗机械应力的能力，设计焊盘图案时应注意控制焊锡量。

※ 焊盘尺寸不随容量、电压、厚度变化，全系列共用本表。

9.2 推荐焊接曲线 Reflow Soldering Profile

- 预热区：室温 → 150℃（60~120 秒）
- 浸润区：150℃ → 200℃（60~90 秒）
- 峰值温度：250℃（最大 260℃），持续 20~40 秒
- 冷却区：自然冷却至室温（≤ 30℃/分钟）

※ 波峰焊：锡炉 250~260℃，浸入 3~5 秒；手工焊：20 W 烙铁，尖端 ≤ 1.0 mm，3 秒内完成。

9.3 自动贴装 Mounting

- 产品在电路板贴装时不应受到过大的冲击
- 必须定期对吸头和定位爪进行检查、维修和更换
- 双面贴装时建议增加支撑 pin，防止基板弯曲

9.4 储存条件 Storage

- 储存温度：5 ~ 40℃；储存湿度：≤ 70%RH
- 保质期：自生产之日 1 年；编带拆封后 3 个月内使用
- 高介电常数电容器（COG 等）的容值会随时间逐渐减小，经 150℃ 热处理 1 小时后可恢复到初始值

10. 修订记录与免责声明 Revision History & Disclaimer

10.1 修订记录 Revision History

版本	日期	修订内容	登记者
V1.0	2026-09-20	新制定；系列规格书，覆盖 0201 封装 COG 介质 50V（电压码 500）共 70 个型号；依据《容盛微 MLCC 产品规格书生成体系 V1.7》	容盛微编制组

10.2 免责声明 Disclaimer

本规格书数据为容盛微 MLCC 的标准测试值，实际性能可能因使用条件（温度、湿度、电压、频率等）不同而有所差异。本规格书内容如有变动，恕不另行通知，以最新版规格书为准。

覆盖声明：本规格书适用于 0201 封装 COG 介质 50V（电压码 500）的全部 70 个型号，型号清单见第 0.5 节。

数据来源：产品规格书体系 V1.7 · 工程参数依据《多层片式瓷介电容器 承认书 RCC-JS-001》（第 3 章命名规则 / 第 5 章尺寸 / 第 6 章技术要求 / 第 7 章包装）· 特性曲线为按介质特性参数绘制的典型曲线 · 型号清单由容盛微命名规则引擎与官网型号库生成。

※ 特别说明：按《容盛微文档生成规范》RCC-GF-000 第 3 条，本规格书不附加参考文献栏；所引用的外部标准、上位规范与承认书已在前置页「引用标准与引用规范」栏内逐条列明。

— 文档结束 END OF DOCUMENT —

惠州市容盛微科技有限公司 · www.mlccon.com

© 2026 惠州市容盛微科技有限公司 · 文档编号 RCC-JS-SER-0201COG-500 · 版本 V1.0-2026